



Look Beyond
Semiconductor

Investor Relations 2018



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 LB세미콘(주)(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘€’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로는 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.
(과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 회사가 발행하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.



LBSemicon



Contents

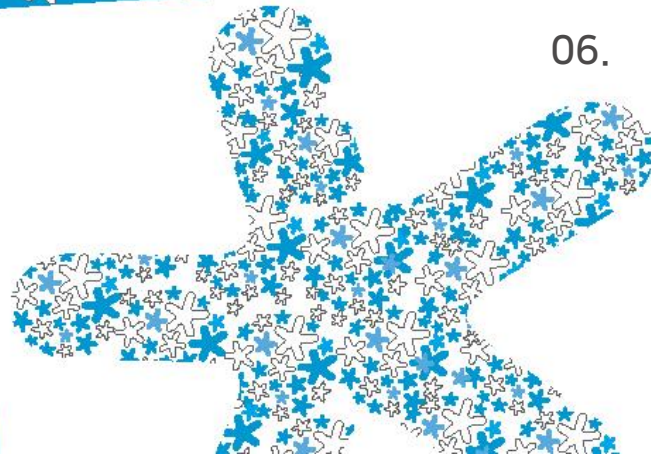
- I. Company Overview
- II. Industry Overview
- III. Competitive Edge
- IV. Investment Highlights
- Appendix



Chapter 1

Company Overview

01. Company Identity
02. Company Profile
03. Milestone
04. Business Area
05. Business Chain for DDI
06. Financial Highlights



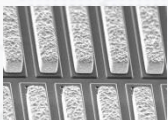
Flip Chip 공정 중 핵심인 Bump 공정, Probe test 및 Assembly 일부 공정 사업 영위



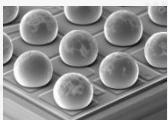
LB Semicon



Bumping



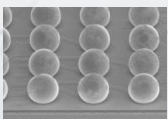
- Au Bump



- Solder Bump



- Cu Pillar Bump



- WLCSP



Probe Test



- DDI, PMIC, CIS, SOC
- Test



Assembly



- COG, T&R

★ Company Snapshot



회 사 명	엘비세미콘(주)
설 립 일	2000년 2월 10일
대 표 이 사	박노만
자 본 금	219 억원
임 직 원 수	448 명
주 소	경기도 평택시 청북면 청북산단로 138
주 요 제 품	Bumping, Probe Test, Assembly
홈 페이지	www.lbsemicon.com

★ CEO Profile



대표이사 박노만

- 경북대 전자공학과
- LG반도체
- 매그나칩반도체
- 現 LB세미콘(주) 대표이사

★ 주요 경영진

이사 구분천

- 서울대학교 경제학과
- 코넬대 경제학 박사
- 現 LB인베스트먼트 대표이사

이사 구분완

- 루이빌대학교 경영학과
- 캘리포니아주립대 MBA
- 現 LB휴넷 대표이사

사외이사 고광모

- 서울대학교 사회학과
- 서울대학교 경영학 석사
- 現 다산E&E 대표이사



2000년 ~ 2005년

- 2000.02 마이크로스케일(주)
회사설립(자본금 10억)
- 2000.06 중소기업청 벤처기업 인증
- 2001.09 삼성전자 EDS TEST 양산 개시
- 2001.11 차세대 일류상품 인증(산업지원부)
- 2002.06 삼성전자 Bump 양산 개시
- 2003.11 500만불 수출의 탑 수상
- 2004.07 최대주주 변경
(황규성 → 밸류미트인베스트먼트)
- 2005.09 최대주주 변경
(밸류미트인베스트먼트 → 구본천)



2006년 ~ 2010년

- 2006.01 LB세미콘(주) 사명변경 /
LG DisplayQUAL 인증
- 2006.02 Magnachip 양산 개시
- 2006.10 Siliconworks 양산 개시
- 2007.12 Solder Bump 양산 개시
- 2008.01 COG 품질인증, 양산
- 2009.07 신성장 동력 스마트 프로젝트
참여기업 선정 (시스템 반도체 분야)
- 2009.12 WLCSP 제품 출하
- 2010.01 부설 연구소 설립

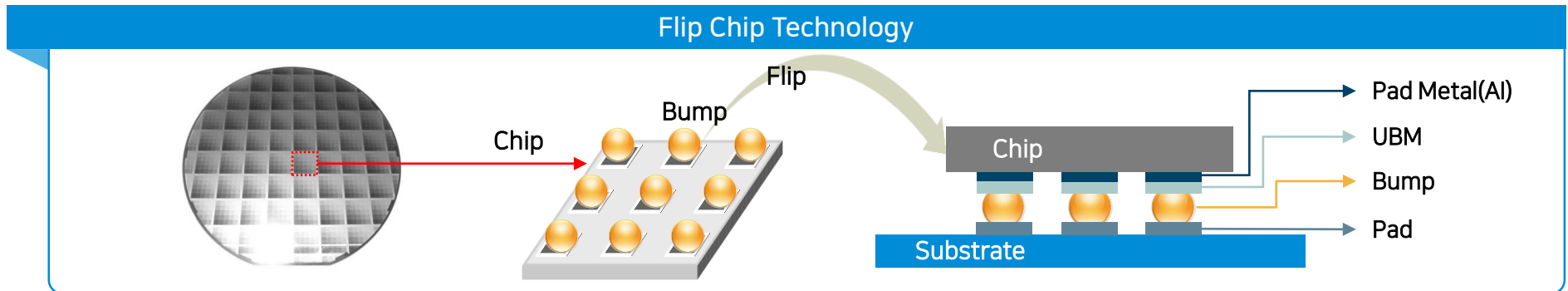


2011년 ~

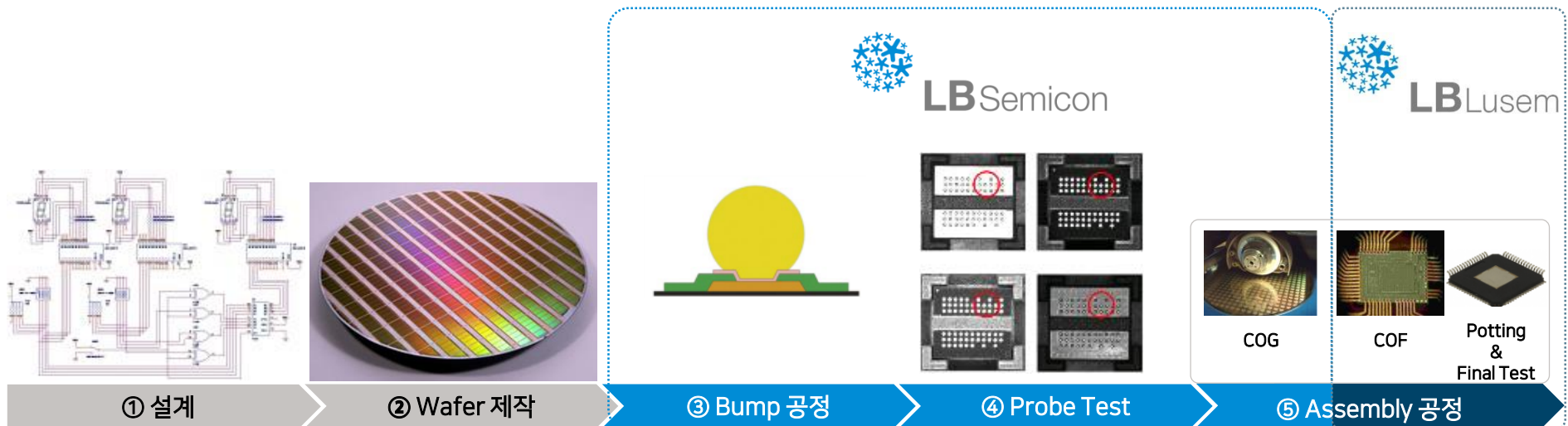
- 2011.01 코스닥 시장 상장
- 2011.04 KDB "글로벌 스타" 선정
- 2012.03 Himax 양산 개시
- 2012.06 PMIC TEST 양산 개시
- 2013.06 Hynix CIS TEST 양산 개시
- 2013.09 12" BUMP 양산 개시
- 2016.01 Novatek 양산 개시
- 2016.12 삼성전자 P.test QUAL 인증
- 2018.02 (주)LB루셈 인수

Flip Chip 공정 중 핵심인 Bump 공정, Probe test 및 Assembly 일부 공정 사업 영위

★ Flip Chip Technology



★ DDI Flip-Chip Bumping 기준 Process

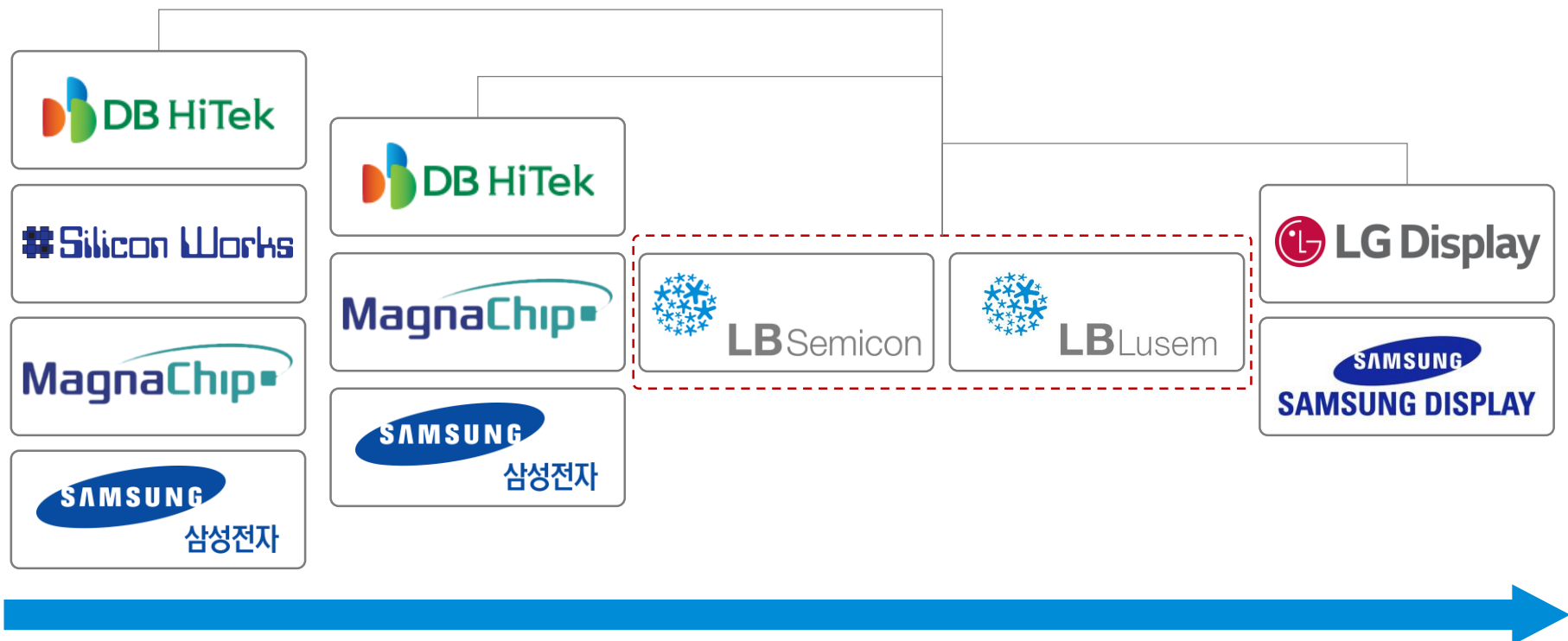


DDI Bump의 경우 전/후방 산업과의 연관효과가 큰 사업

* Display Driver IC Value Chain



DDI Bumping 사업의 경우 디스플레이 및 디스플레이 소재/부품사업자와의 Network가 중요



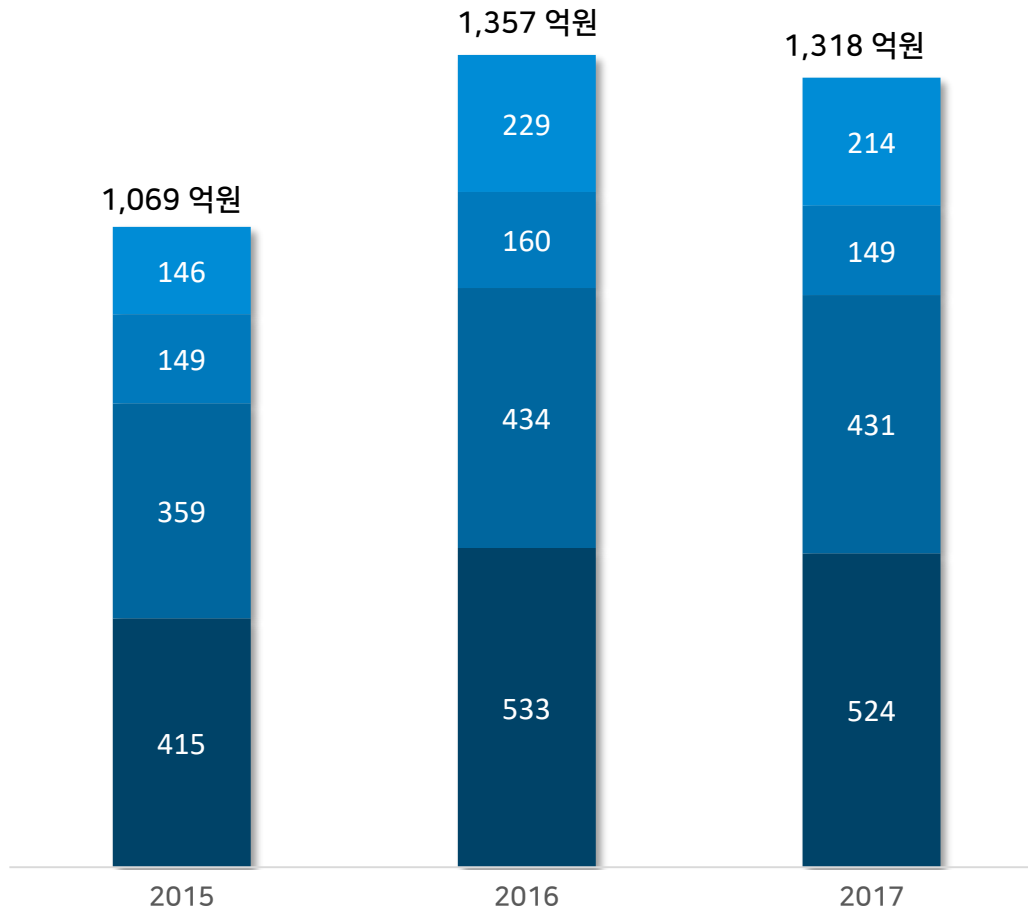
국내외 Major 디스플레이 사업자의 경우 안정적 공급시스템 구축의 일환으로 수직계열화 작업 진행

OLED 패널시장 호조, PMIC/DDI 매출 성장 및 소형 OLED 증가로 인한 매출 증가

★ 공정별 매출 실적

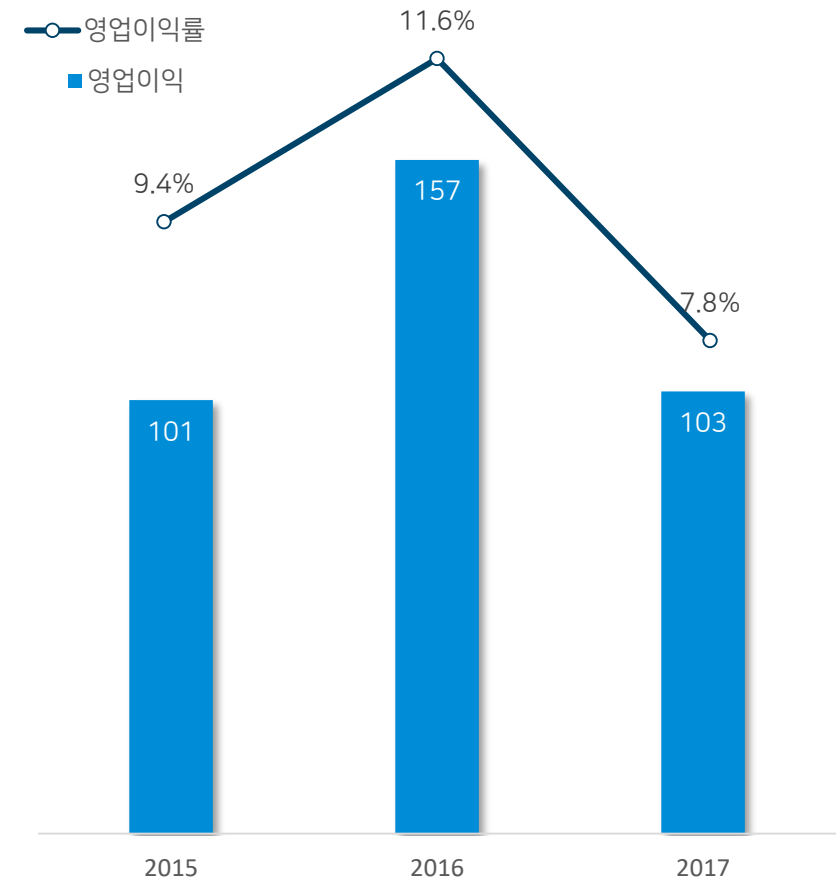
단위: 억 원

■ Au Bump ■ P.Test ■ Solder Bump ■ Ass'y



★ 영업이익 및 영업이익률

단위: 억 원





Chapter 2. Industry Overview

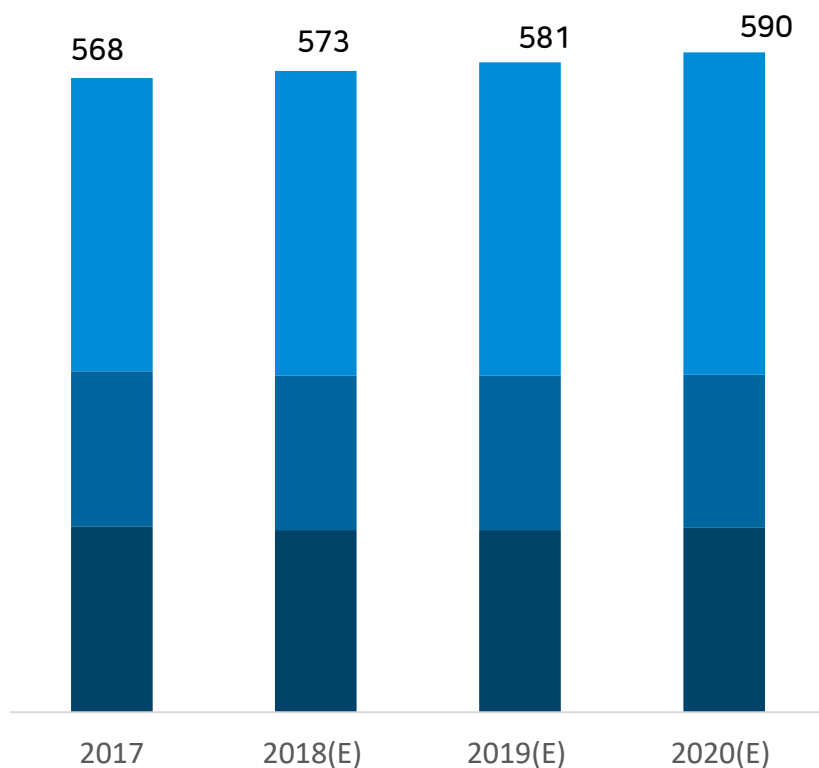
01. 패널 시장의 국내 기업 M/S에 따른 수혜
02. 전방 산업 시장의 성장

대형 및 중·소형 패널시장 확대

* 대형 패널 수요

단위: 백만대/年

■ 노트북 ■ 모니터 ■ TV

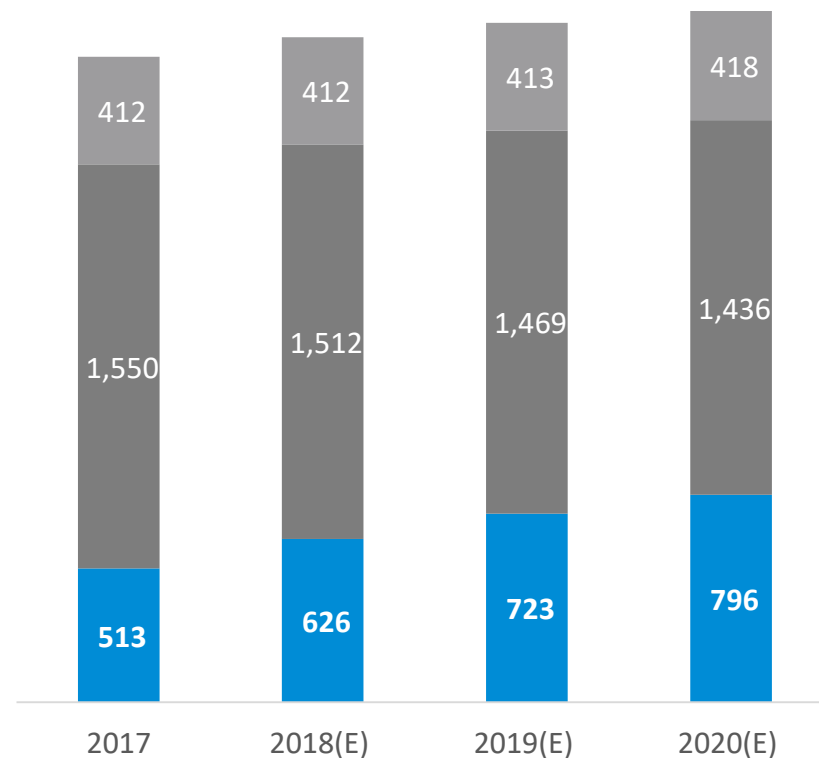


출처: IHS Markit

* 중·소형 패널 수요

단위: 백만대/年

■ OLED 모바일 ■ LCD모바일 ■ 기타

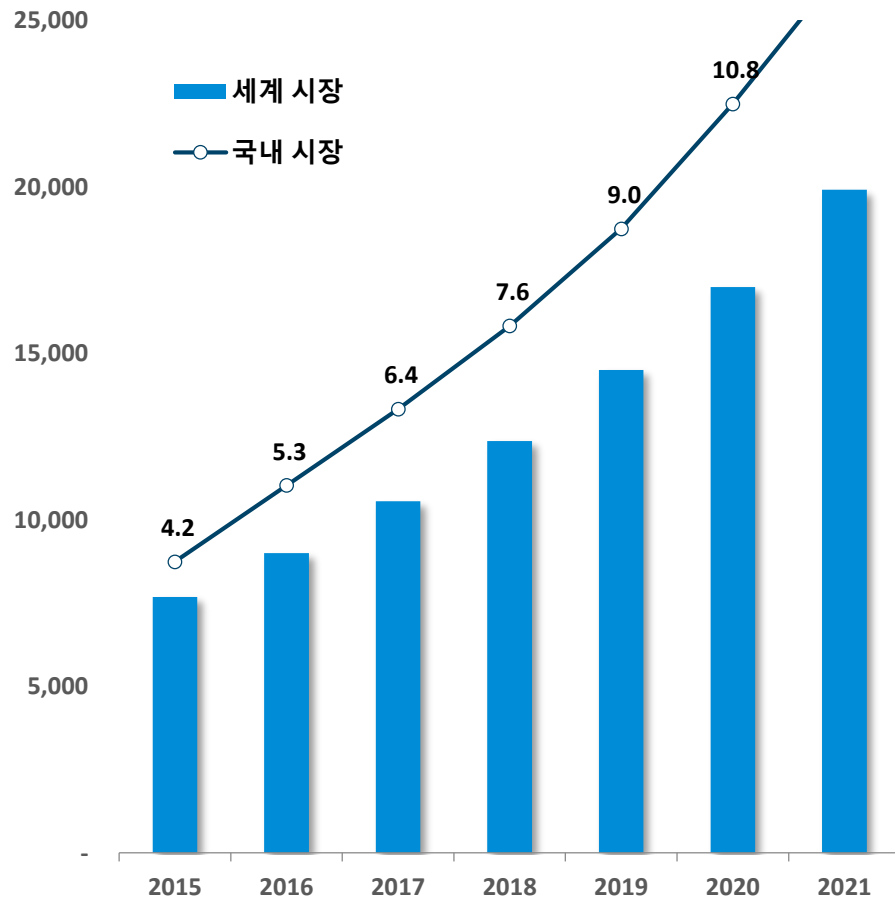


출처: IHS Markit

IoT, Wearable 기기, 자동차 전장 등 전방 시장 성장

* IoT 시장 전망

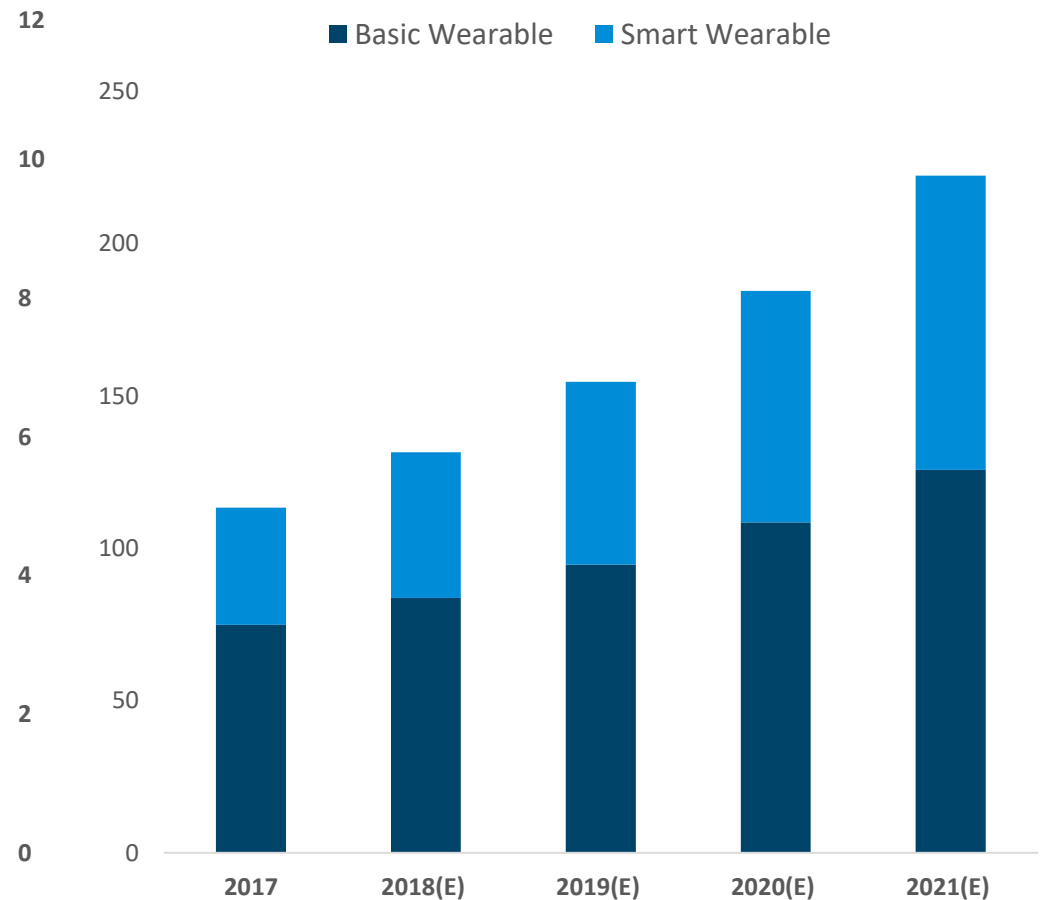
단위: \$100M



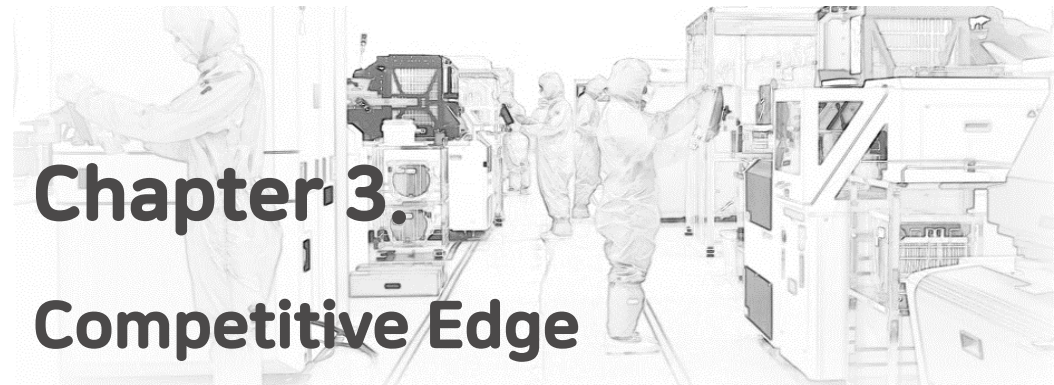
출처: 2016.5 IDC 및 2016.1 미래창조과학부

* Wearable 기기 시장 전망

단위: 출하량 백만대



출처: IDC 2017

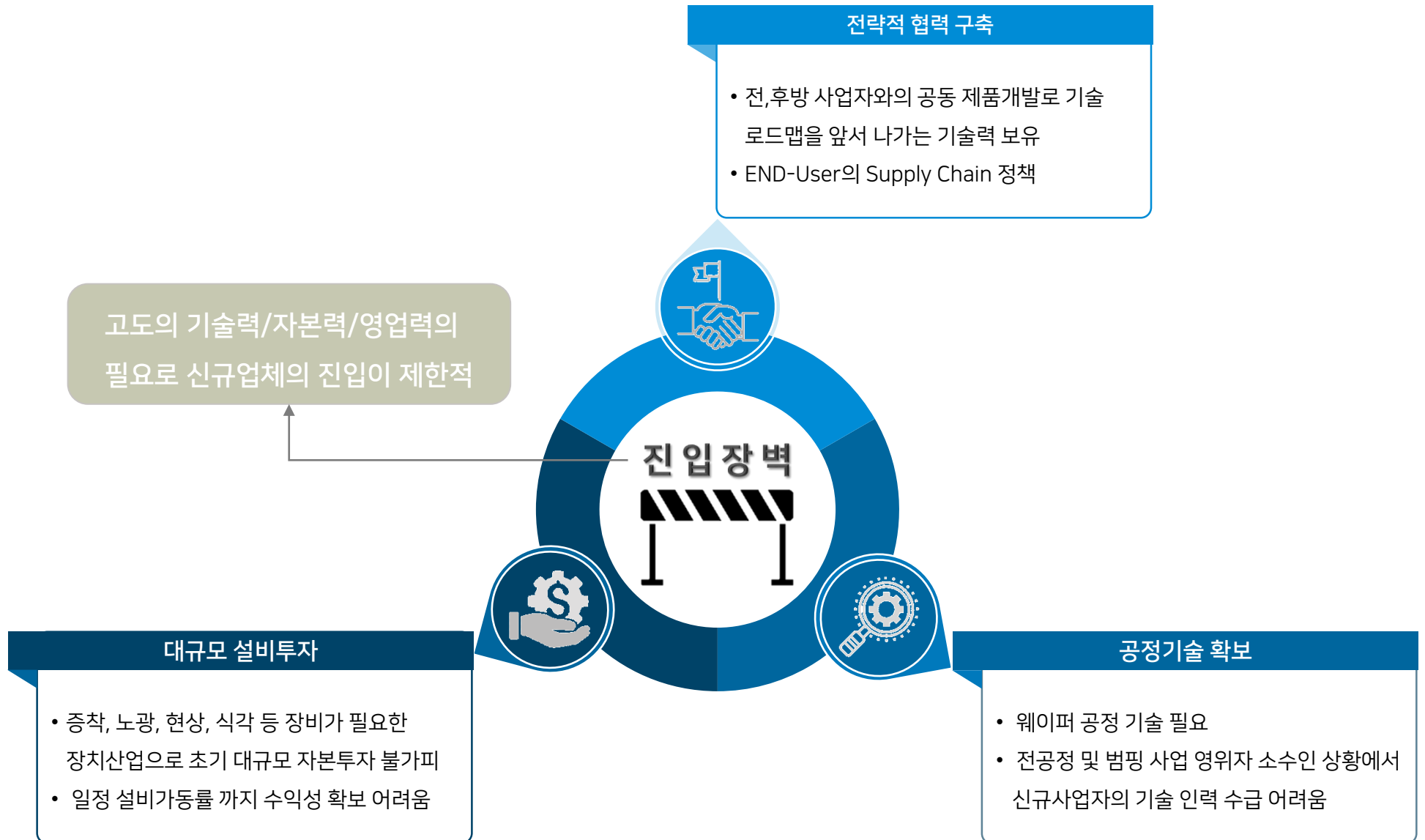


Chapter 3.

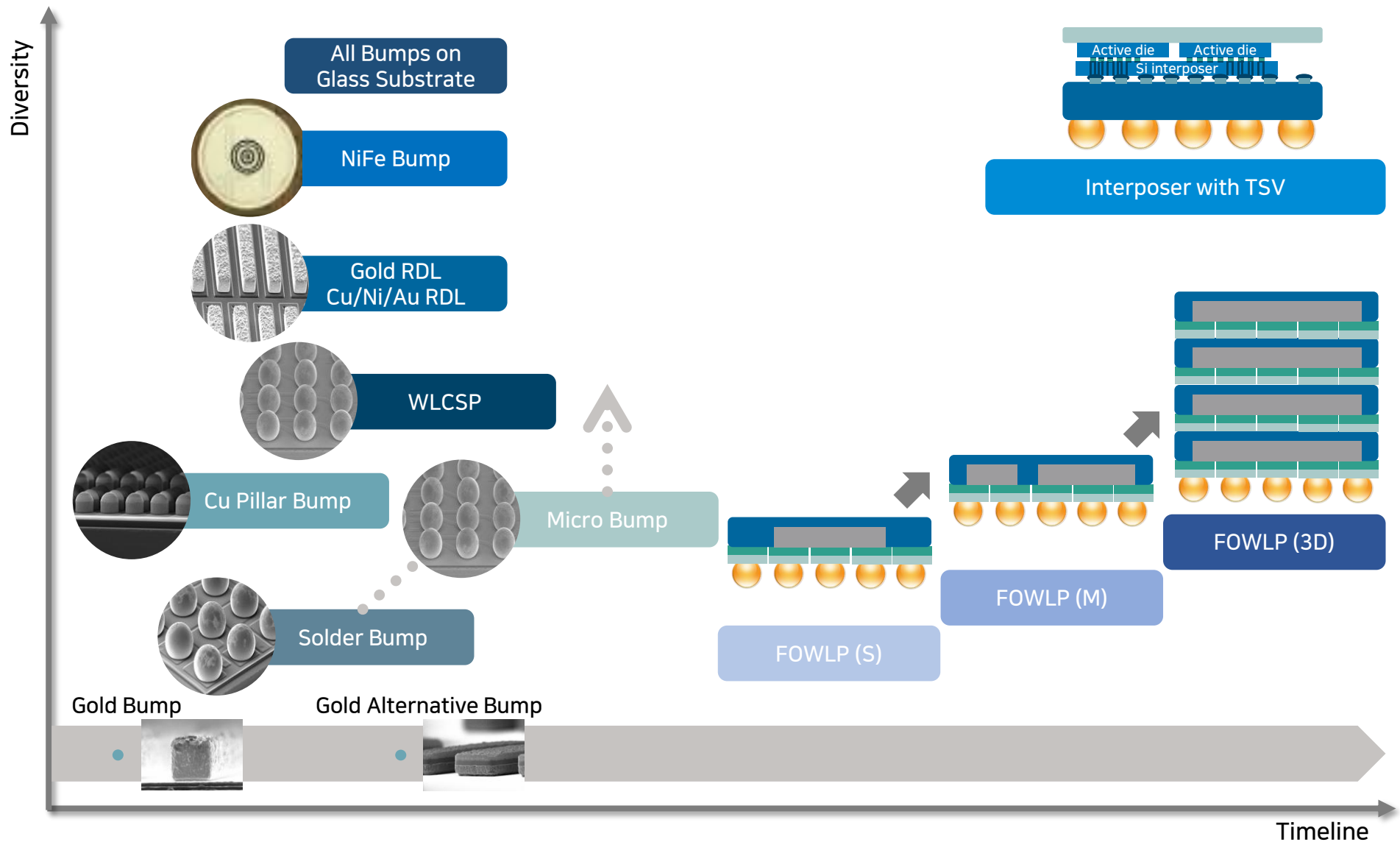
Competitive Edge

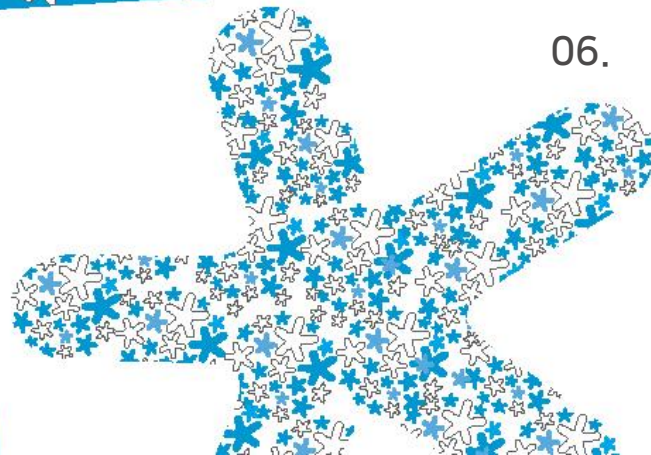
01. 진입장벽 구축
02. R&D Roadmap

자본집약적 사업 특성 및 전략적 제휴를 통한 진입장벽 구축



뛰어난 R&D를 토대로 제품 다양화, 향후 시장 선도 제품 출시를 통해 매출 증대





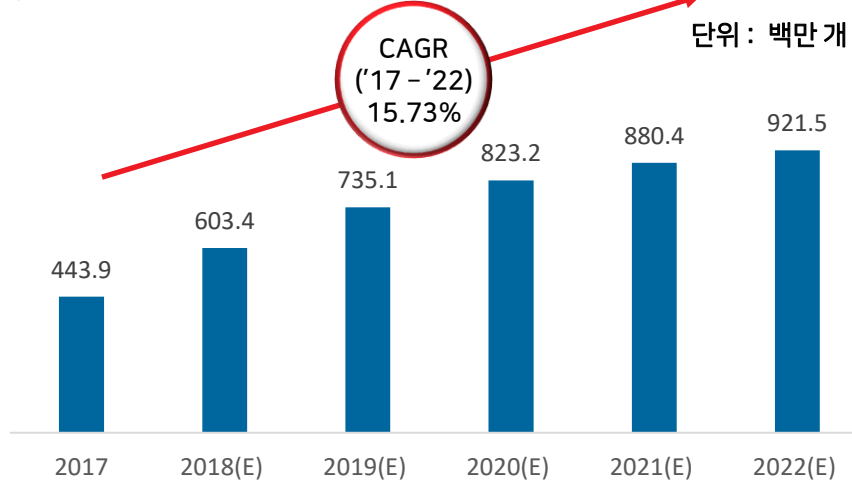
Chapter 3.

Investment Highlights

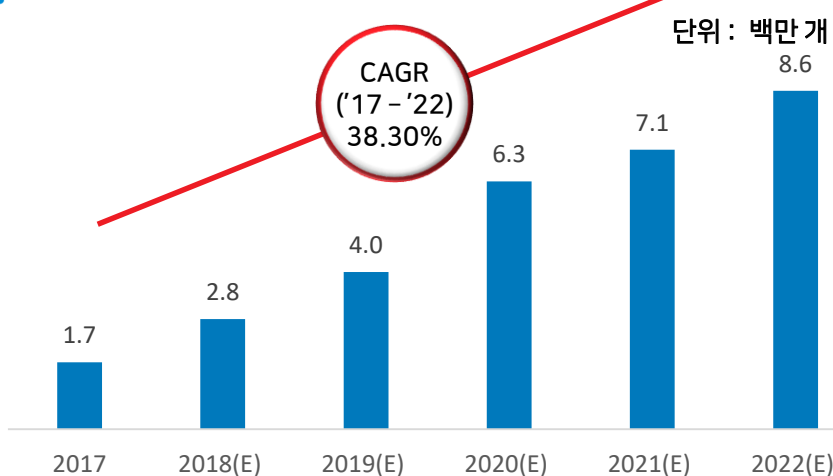
01. OLED 패널 시장확대
02. 고객 다변화
03. 어플리케이션 다변화
04. M&A Synergy Effect
05. Performance Forecast
06. Vision

대형 OLED 패널 시장 확대에 따른 DDI 수요 증가 수혜 국내 패널업체 OLED M/S 확대에 따른 수혜

★ AMOLED - 스마트폰 예상 수요

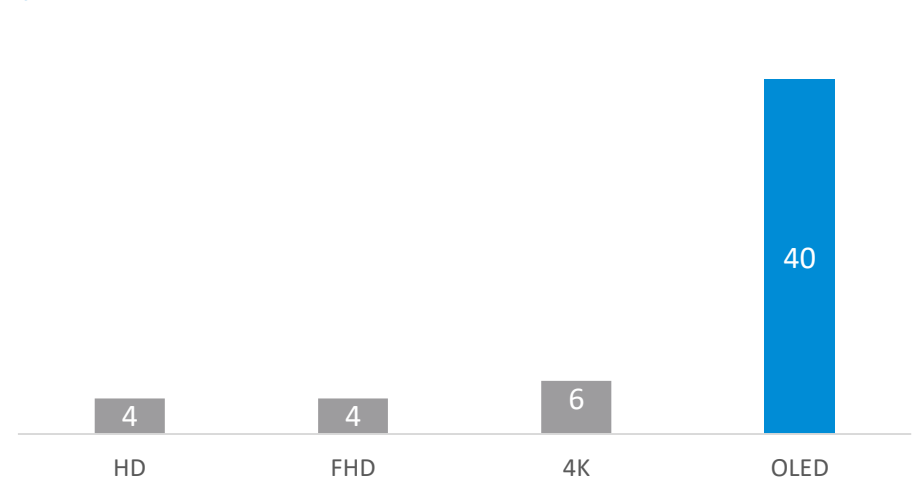


★ AMOLED - TV 예상 수요

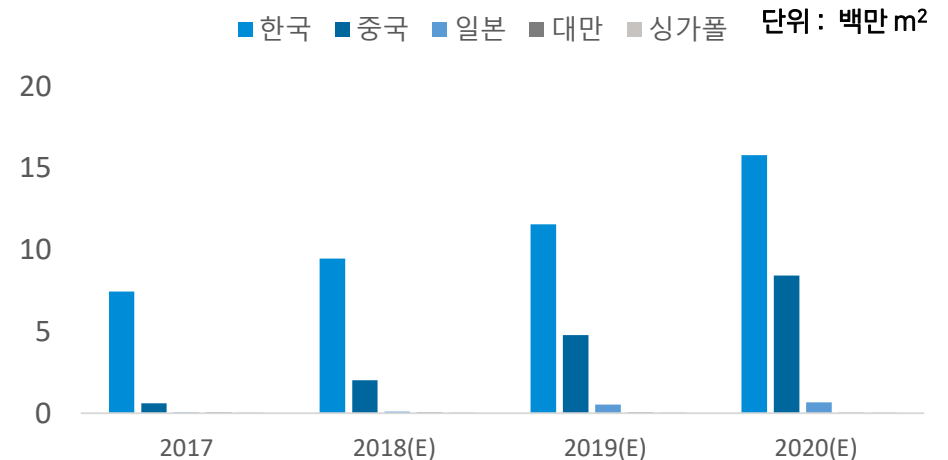


출처:

★ 해상도별 D-IC 채용 수량

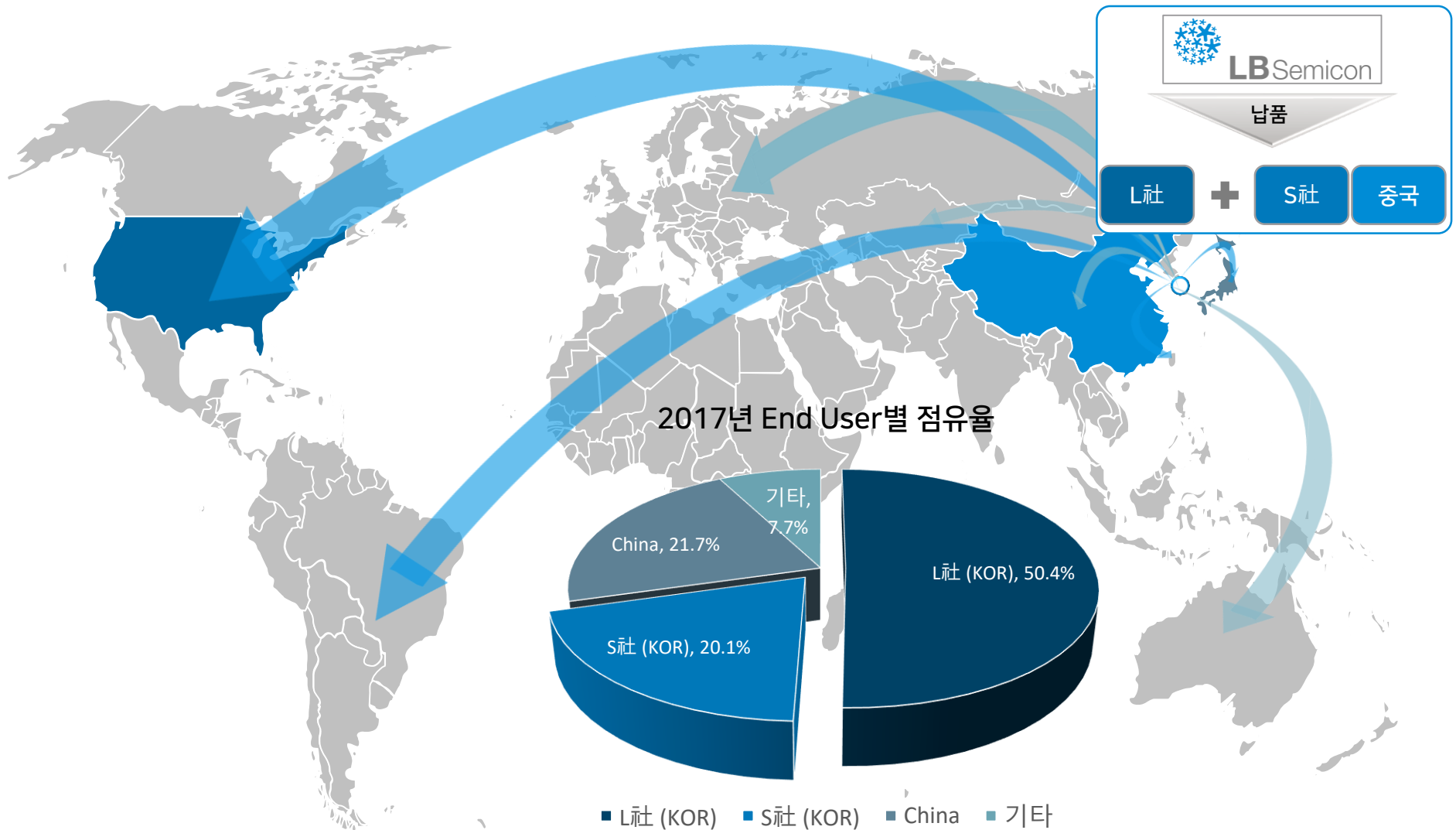


★ Global 지역별 AMOLED Capacity

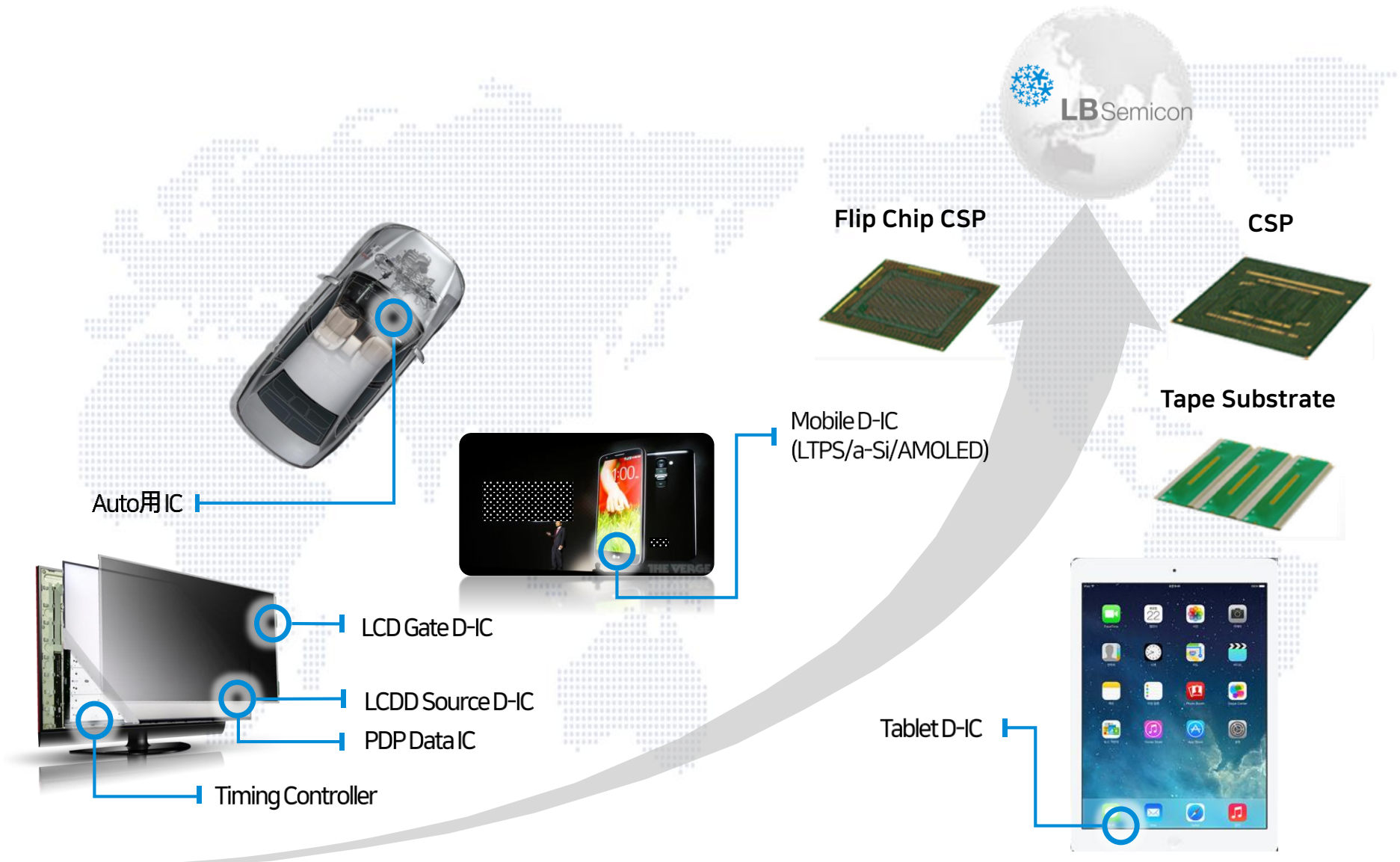


출처: IHS Markit

기존 L社에서 S社 및 중국향 매출 증가를 통한 고객 다변화



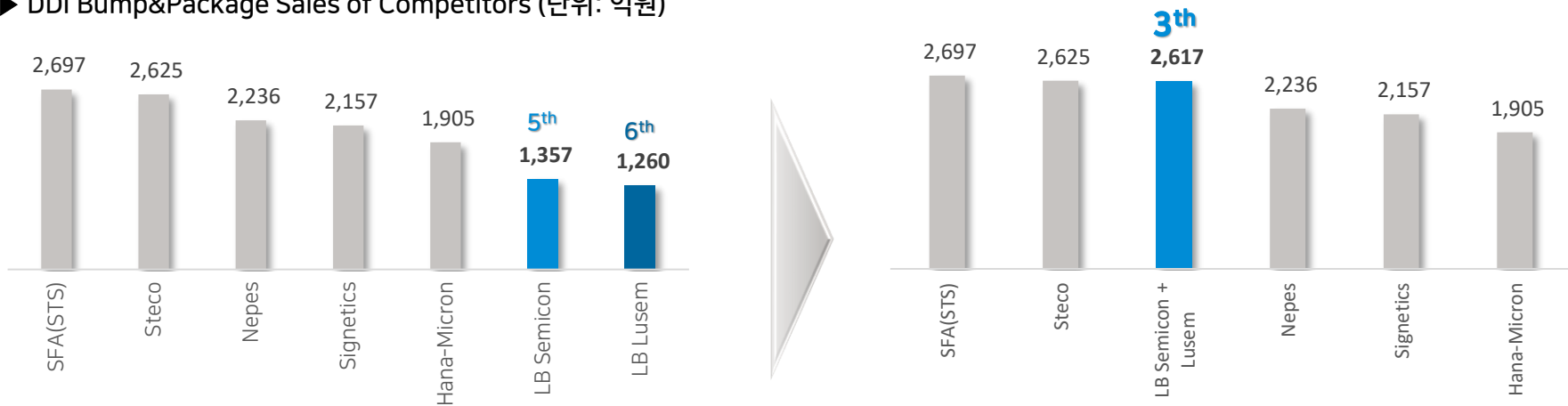
기존 디스플레이 위주의 D-IC에서 PMIC/CIS 등 다양한 어플리케이션 확장



루셈 인수로 COF영역까지 사업영역을 확대, 기존 영업망을 통한 시너지 효과 창출

★ M&A를 통한 Economy of Scale 실현 및 시너지 효과 확보

▶ DDI Bump&Package Sales of Competitors (단위: 억원)



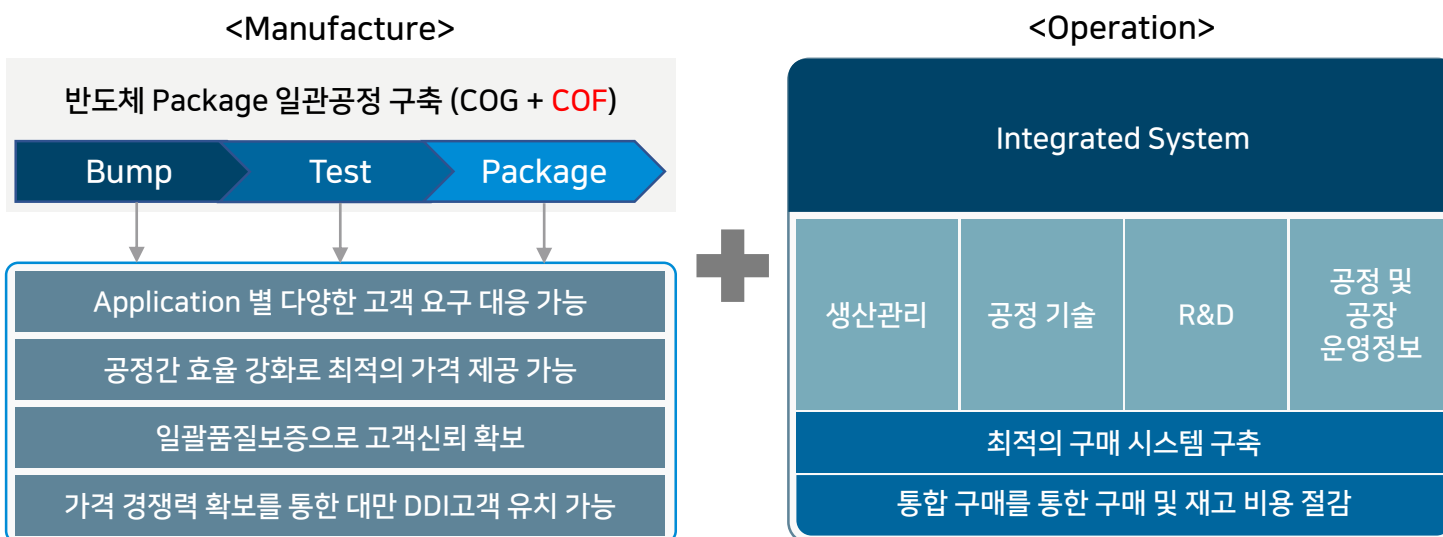
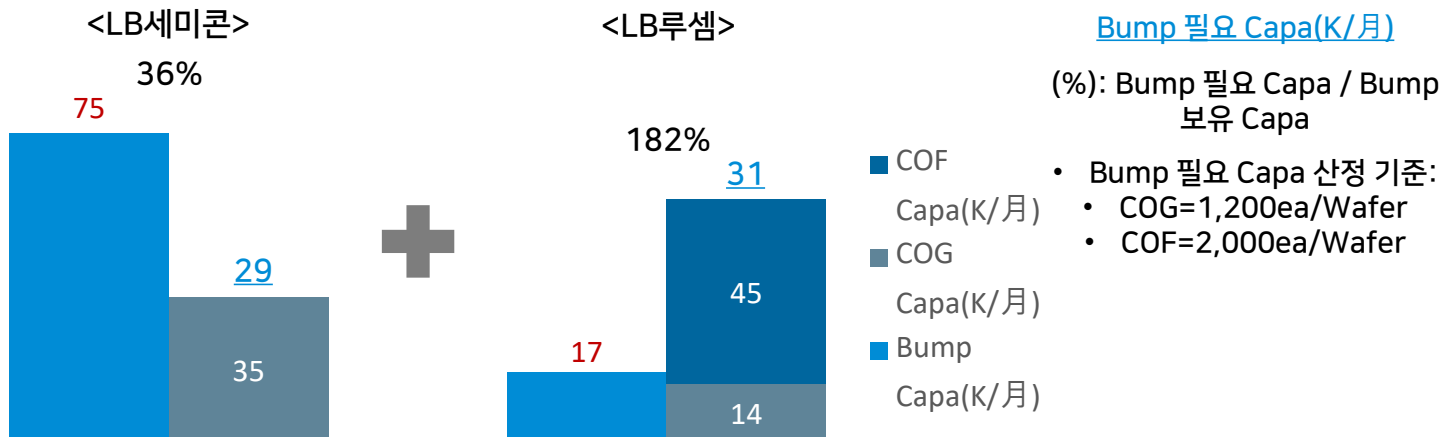
출처: Financial Disclosure in 2016

★ 기존 LB세미콘 영업망을 활용한 LB루셈의 Global M/S 확대



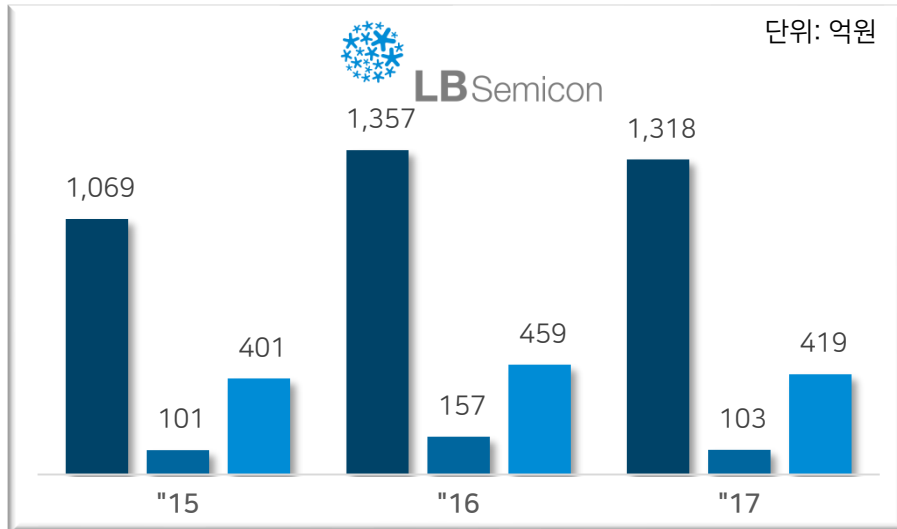
루셈 인수로 인한 운영 효율화 및 비용절감을 통해 규모의 경제 실현

★ Turnkey service 구축 및 Integrated system 확보를 통한 비용절감

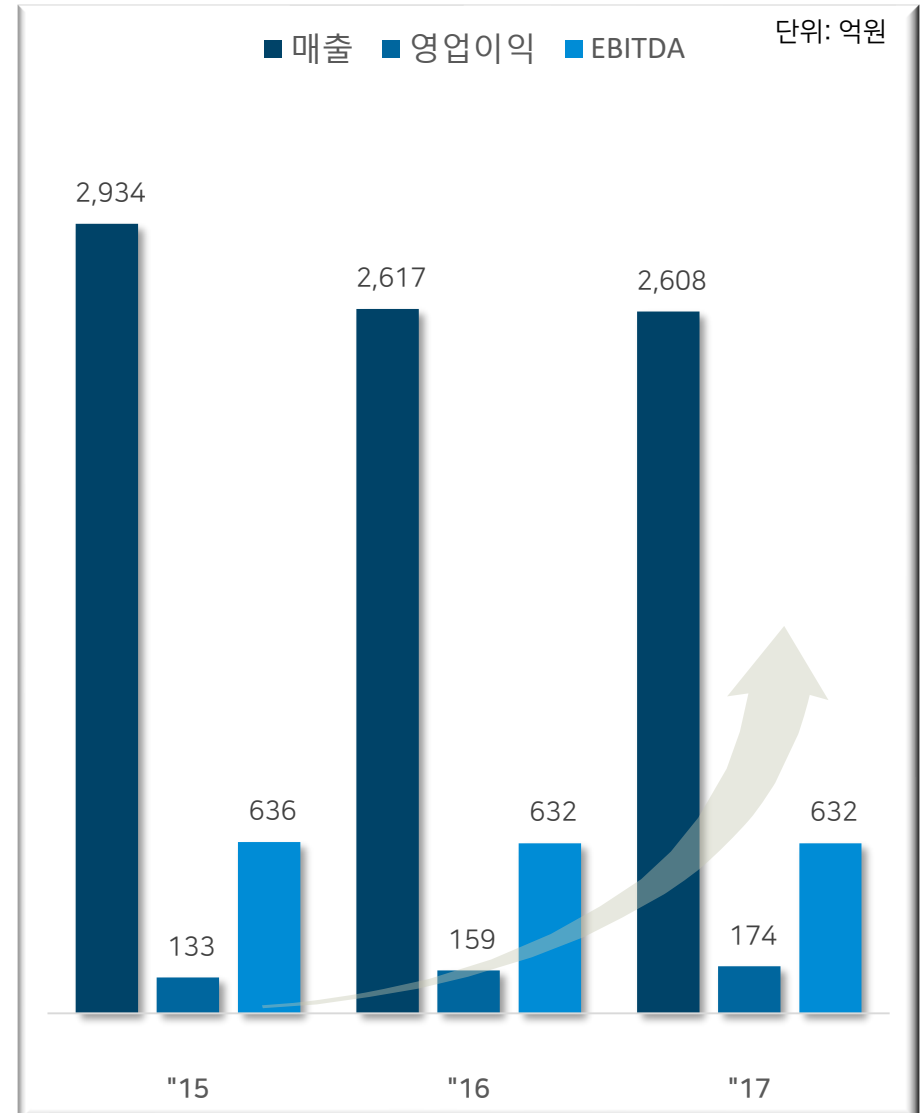


Turnkey service 및 Integrated system 구축을 통해 향후 매출 및 영업이익 증가 예상

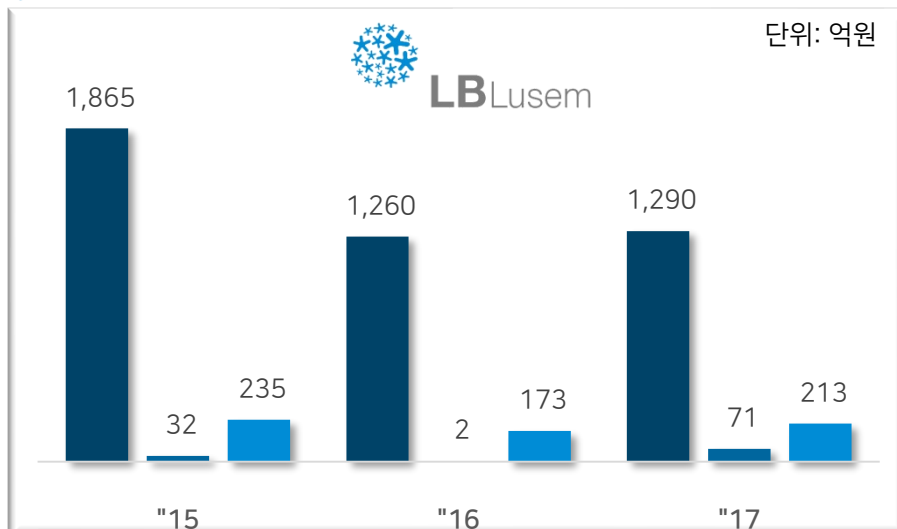
★ LB세미콘



★ LB세미콘 및 LB루셈 통합

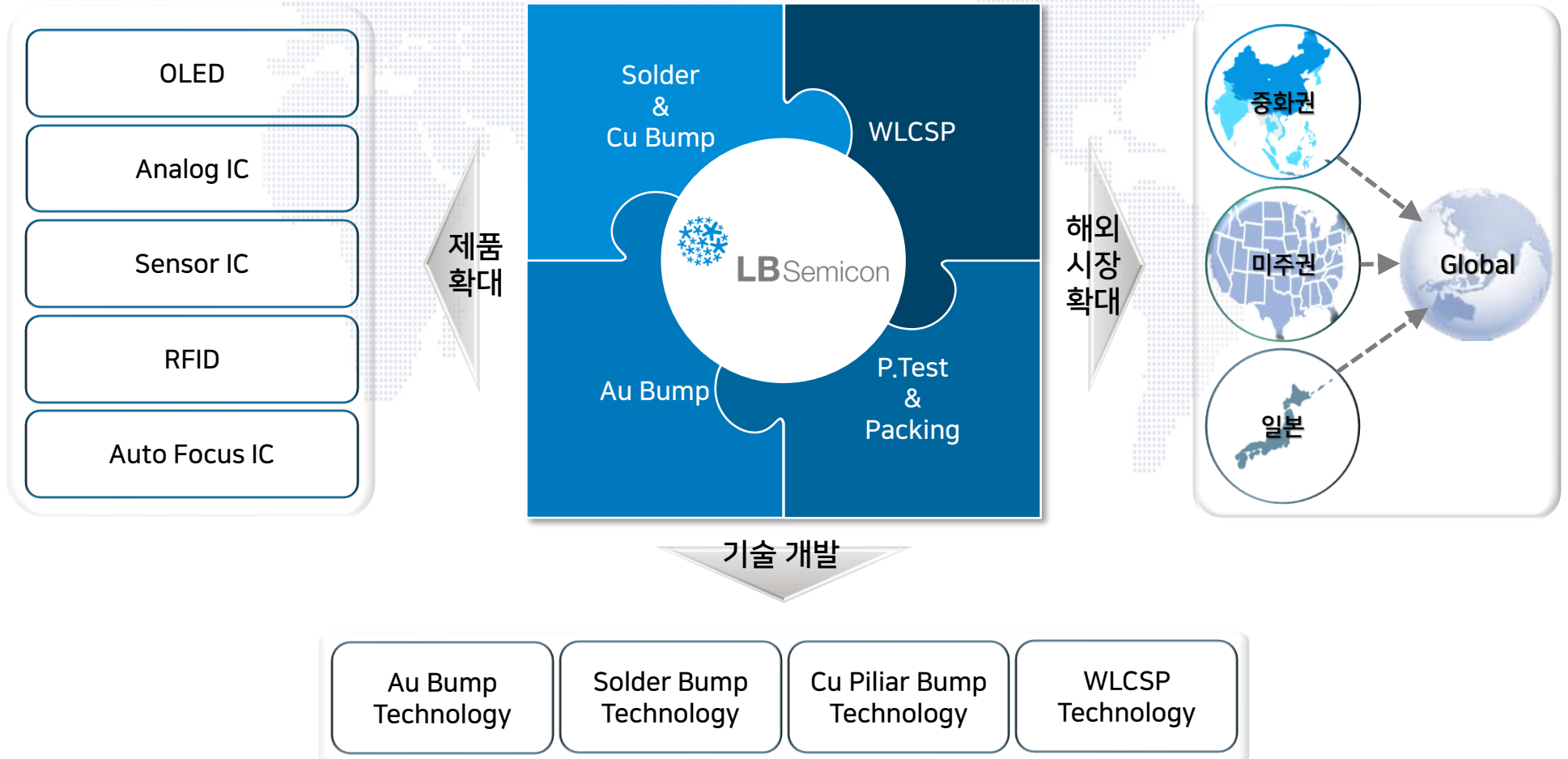


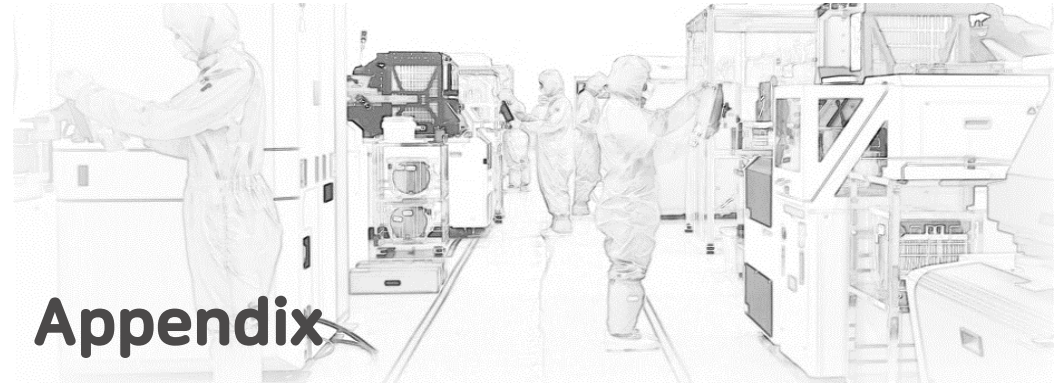
★ LB루셈



전방사업의 성장을 선도하는 기술력과 사업영역 확대를 통한 전방위 성장

Global Total OSAT Company





Appendix

01. Summary of Financial Statements
02. LB루셈 Company Profile
03. LB루셈 Summary of Financial Statements



* 요약 재무상태표

(단위: 억원)

구분	2015	2016	2017
유동자산	594	521	796
비유동자산	1,658	1,602	1,568
자산총계	2,252	2,123	2,364
유동부채	898	757	924
비유동부채	537	423	436
부채총계	1,435	1,180	1,360
자본금	219	219	219
기타자본 구성요소	361	361	361
이익잉여금	237	362	424
자본총계	817	942	1,004

* 요약 손익계산서

(단위: 억원)

구분	2015	2016	2017
매출액	1,069	1,357	1,318
매출원가	907	1,119	1,120
매출총이익	162	238	198
판관비 등	61	81	95
영업이익(손실)	101	157	103
영업외수익	28	68	62
영업외비용	216*	62	70
법인세차감전이익(손실)	(87)	163	95
법인세비용	(5)	28	15
당기순이익(손실)	(82)	135	80

* 2015년 영업외비용에는 기타손실 및 금융원가 외 지분법 손실 약 53억원이 포함

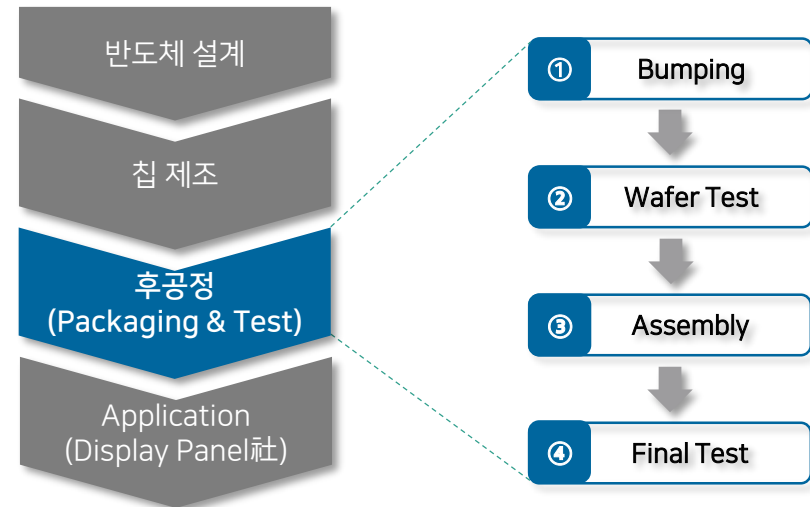
★ Company Snapshot



LB Lusem

회 사 명	엘비루셈(주)
설 립 일	2004년 7월 7일
대 표 이 사	이상훈, 박노만
자 본 금	108 억원
임 직 원 수	384 명 (2018년 2월 28일 기준)
주 소	경기도 구미시 4공단로 7길 9 (구포동)
주 요 제 품	Driver IC(TCP, COF), RFID, T-CON
홈 페이지	www.lusem.com

★ 사업 영역 - 반도체 후공정 임가공 Service 제공



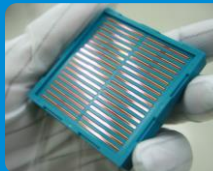
★ 생산 품목 - 디스플레이 구동 Driver IC

COF
(Chip On Film)



- Driver IC 칩을 Film 형태로 회로기판(PCB)에 장착
- 주로 TV 및 모니터 등 대화면 기기에 적용
- 최근에는 웨어러블 및 모바일 등의 소형으로 적용 범위 확대

COG
(Chip on Glass)



- Driver IC 칩을 디스플레이 패널 위에 직접 탑재
- 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기에 적용
- COF에 비하여 후공정 과정이 간단

★ 요약 재무상태표

(단위: 억원)

구분	2016	2017
유동자산	859	704
비유동자산	397	394
자산총계	1256	1098
유동부채	177	360
비유동부채	76	53
부채총계	253	413
자본금	108	108
자본잉여금	38	37
이익잉여금	857	540
자본총계	1003	685

★ 요약 손익계산서

(단위: 억원)

구분	2016	2017
매출액	1260	1290
매출원가	1129	1136
매출총이익	131	154
판관비 등	129	83
영업이익(손실)	2	71
영업외수익	25	17
영업외비용	13	19
법인세차감전이익(손실)	14	69
법인세비용	4	13
당기순이익(손실)	10	56

